

平成 27 年 12 月 22 日

各 位

上場会社名 T O W A 株式会社
代 表 者 代表取締役社長 岡田 博和
コード番号 6315
問合せ先責任者 執行役員経営企画本部長
蒲生 喜代重
TEL (075) 692 -0251

新製品「CPM1080」販売開始に関するお知らせ

当社は、独自の『コンプレッション技術』を活用する事により、高い成長が見込まれるウエハレベルパッケージ（以下、WLP）用にホールドフレーム構造を採用した半導体製造装置『CPM1080』を開発し、販売を開始いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開発背景

半導体のパッケージ技術は薄型化・高集積化への対応が求められており、従来のリードフレームや基板にチップを搭載して封止（モールド）するのではなく、パッケージの最小化・極薄化を実現するために基板等を省いてモールドする WLP が台頭してきております。また、高機能化も同時に進んでおり、FOWLP（Fan-Out Wafer Level Package）技術への対応が求められております。

WLP は既に一部の半導体メーカーが液状樹脂を用いて生産している実績がありますが、価格競争力を持つべく、低コストの成形プロセスが望まれています。このニーズに応えるため、樹脂コストを大幅に低減できる顆粒樹脂対応を提案するとともに、液状樹脂でも対応ができる FOWLP への総合展開が可能な装置を開発いたしました。

WLP に代表されるモールド面積の大型化は、成形時の反りの発生が大きな課題となっておりますが、先般、欧州の研究機関 IMEC が当社の本装置を用いて、反り対策の優位性を検証した論文が発表されるなど、市場のニーズに応える新製品であると期待されております。

2. 新製品の概要

(1) 製品名

CPM1080

(2) 製品の特長

- ・樹脂の流動距離をゼロ或いは最短にする低圧成形
- ・高速高真空達成が可能なFM機能
- ・ダイダウン金型構造
- ・顆粒樹脂と液状樹脂のいずれにも対応可能
- ・パネルサイズ□320 mm、ウエハサイズ 12 インチ(Φ300 mm)の成形可能
- ・極薄型パッケージに対応する高精度位置決めプレス（ホールドフレーム構造）



3. 販売計画等

- ・販売開始時期 2016 年 1 月
- ・販売目標 年間 10 台（2017 年 3 月期）

以上